

# 2025年3月期 決算説明資料

2025年5月9日



## 主な説明内容

---

1. 2025年3月期 実績
2. 第二次中期経営計画
3. 2026年3月期 予想
4. TOPICS

## 主な説明内容

---

- 1. 2025年3月期 実績**
2. 第二次中期経営計画
3. 2026年3月期 予想
4. TOPICS

## 2025年3月期 サマリー

受注高  
474.2 億円  
(前年同期比 ▲10.0%)

売上高  
534.7 億円  
(前年同期比 +6.0%)

営業利益  
88.8 億円  
(前年同期比 +2.5%)

経常利益  
94.0 億円  
(前年同期比 +3.5%)

当期純利益  
81.2 億円  
(前年同期比 +26.0%)

### ▶ 受注高

- ・ 上期は中国での半導体内製化に向けた受注が牽引したものの、下期からは経済動向やアメリカの政策動向の不透明感により減速。
- ・ 当社独自のコンプレッション装置・金型は高い受注水準を維持。

### ▶ 売上高

- ・ 中国やその他アジア地域向けの売上が堅調に推移。
- ・ 装置納入台数の増加や顧客稼働率改善を背景にTSS（トータル・ソリューション・サービス）の売上高が大きく増加。

### ▶ 利益

- ・ 人員増や研究開発費の増加にともない販売管理費が増加したものの、売上高の増加により、各段階利益ともに増益。

こちらは2025年3月期決算のサマリーです。

受注高につきましては、上期は中国での半導体内製化に向けた受注が牽引し、堅調に推移いたしました。しかし、下期に入ると経済動向やアメリカの政策動向などの先行き不透明感から、投資を様子見する姿勢が現れたため、減速いたしました。

当社独自のコンプレッション装置・金型の受注は高い水準を維持することが出来ました。

売上高につきましては、受注残を確実に売上につなげ、中国やその他アジア地域向けの売上が堅調に推移いたしました。

また、装置納入台数の増加や顧客稼働率改善を背景にTSS（トータル・ソリューション・サービス）の売上高が大きく増加いたしました。

各段階利益につきましては、人員増や研究開発費の増加にともない販売管理費が増加したものの、売上高の増加により、各段階利益ともに増益となりました。

## 2025年3月期 連結業績結果

(単位：億円)	2024/3期 実績	2025/3期 実績	前期比	2025/3期 修正予想	予想比
売上高	504.7	534.7	+ 30.0 (+ 6.0%)	540.0	▲ 5.2 (▲ 1.0%)
営業利益	86.6	88.8	+ 2.1 (+ 2.5%)	92.0	▲ 3.1 (▲ 3.5%)
営業利益率	17.2%	16.6%	▲ 0.6pt	17.0%	▲ 0.4pt
経常利益	90.7	94.0	+ 3.2 (+ 3.5%)	97.6	▲ 3.5 (▲ 3.7%)
当期純利益	64.4	81.2	+ 16.7 (+ 26.0%)	78.7	+ 2.5 (+ 3.2%)

※当期純利益 = 親会社株主に帰属する当期純利益

こちらは通期の業績結果です。

売上高は、半導体内製化を推し進める中国や、地政学的リスクを背景に活発な投資が続く東南アジアでの需要を獲得出来たことから、前期比で増収となりました。

利益につきましては、人員増や研究開発費の増加にともない販売管理費が増加したものの、売上高の増加により、各段階利益ともに増益となりました。  
なお、当期純利益には、一部の投資有価証券を売却したことによる売却益などが含まれております。

詳細については、12ページの増減要因分析をご覧ください。

## 2025年3月期 セグメント別売上高

(単位：億円)

	2024/3期 実績	2025/3期 実績	前期比	2025/3期 修正予想	予想比
<b>売上高</b>	<b>504.7</b>	<b>534.7</b>	<b>+ 30.0</b> (+ 6.0%)	<b>540.0</b>	<b>▲ 5.2</b> (▲ 1.0%)
<b>半導体事業</b>	<b>383.2</b>	<b>395.3</b>	<b>+ 12.1</b> (+ 3.1%)	<b>399.0</b>	<b>▲ 3.7</b> (▲ 0.9%)
<b>メディカル デバイス事業</b>	<b>21.5</b>	<b>22.6</b>	<b>+ 1.1</b> (+ 5.3%)	<b>22.8</b>	<b>▲ 0.2</b> (▲ 0.7%)
<b>新事業</b>	<b>75.8</b>	<b>94.2</b>	<b>+ 18.4</b> (+ 24.4%)	<b>95.6</b>	<b>▲ 1.4</b> (▲ 1.4%)
<b>レーザ事業</b>	<b>24.2</b>	<b>22.6</b>	<b>▲ 1.6</b> (▲ 6.7%)	<b>22.6</b>	<b>± 0.0</b> (± 0.0%)

 This material is the property of TOWA CORPORATION

6

こちらはセグメント別の売上高です。

半導体事業につきましては、中国地域やその他アジア地域での投資が堅調であったことや顧客稼働率の改善により半導体製造用等精密金型の売上高が増加し、前期比で3.1%増となりました。

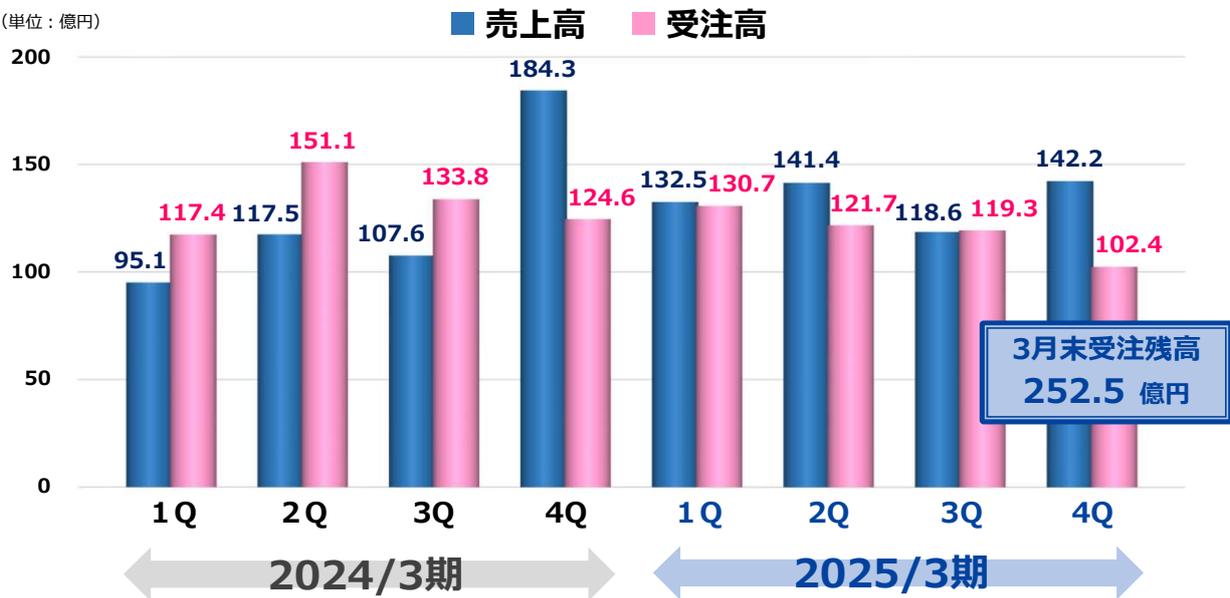
メディカルデバイス事業につきましては、医療機器向けの成形品や組立品の需要が堅調であったことから、前期比で5.3%増となりました。

新事業につきましては、装置納入台数の増加や顧客稼働率改善を背景にTSSの売上高が大きく増加し、前期比24.4%増となりました。

レーザ事業につきましては、顧客稼働率の低迷により主力製品であるレーザトリマの売上高が低調であったことから、前期比6.7%減となりました。

## 受注・売上高の推移

(単位：億円)



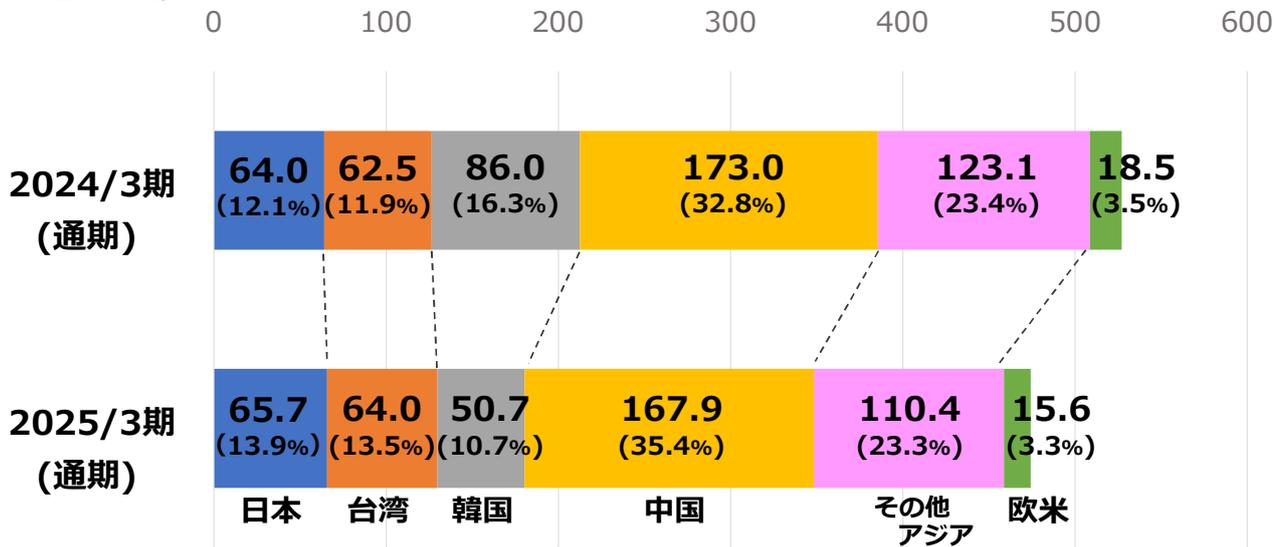
こちらは四半期ごとの受注・売上高の推移です。

受注高につきましては、第1四半期、第2四半期は中国での半導体内製化に向けた投資により堅調に推移したものの、第3四半期以降は経済動向やアメリカの政策動向などの先行き不透明感から、投資を様子見する姿勢が現れたため、減速いたしました。

売上高につきましては、受注残を確実に売上につなげることができました。

## 地域別受注構成比率（仕向地ベース）

（単位：億円）



こちらは地域別の受注高です。金額は仕向地ベースとなっております。例えば、韓国メーカーでも納入された地域が中国であれば、中国の受注高になっています。

台湾は本格的な回復には至っていないものの、ブレードなどの消耗品やTSS（トータル・ソリューション・サービス）の受注が増加しました。

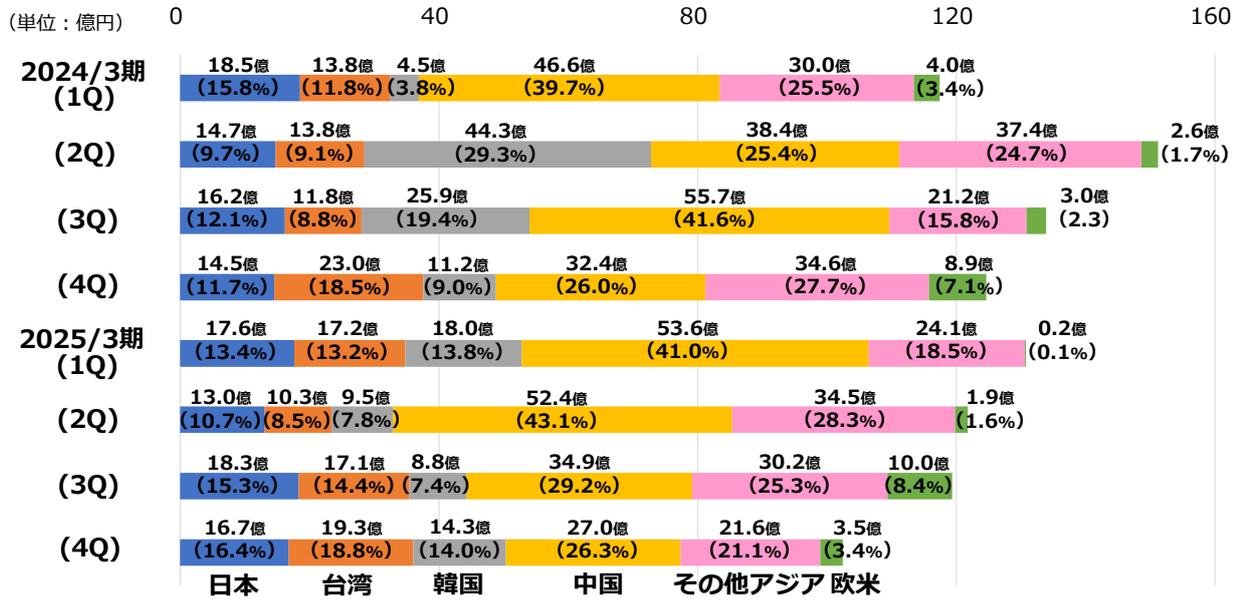
韓国は、生成AI関連向けで前期に多くの受注が集中した反動により減少いたしました。

中国は、上期は半導体内製化に向けた投資が堅調だったものの、下期の受注が低調であったことから微減となりました。

その他アジアは、前期比では減少となっているものの、堅調な受注が継続いたしました。

なお、詳細なデータを決算補足資料として当社Webサイトに掲載しておりますので、あわせてご参照ください。

## 地域別受注構成比率推移（仕向地ベース）

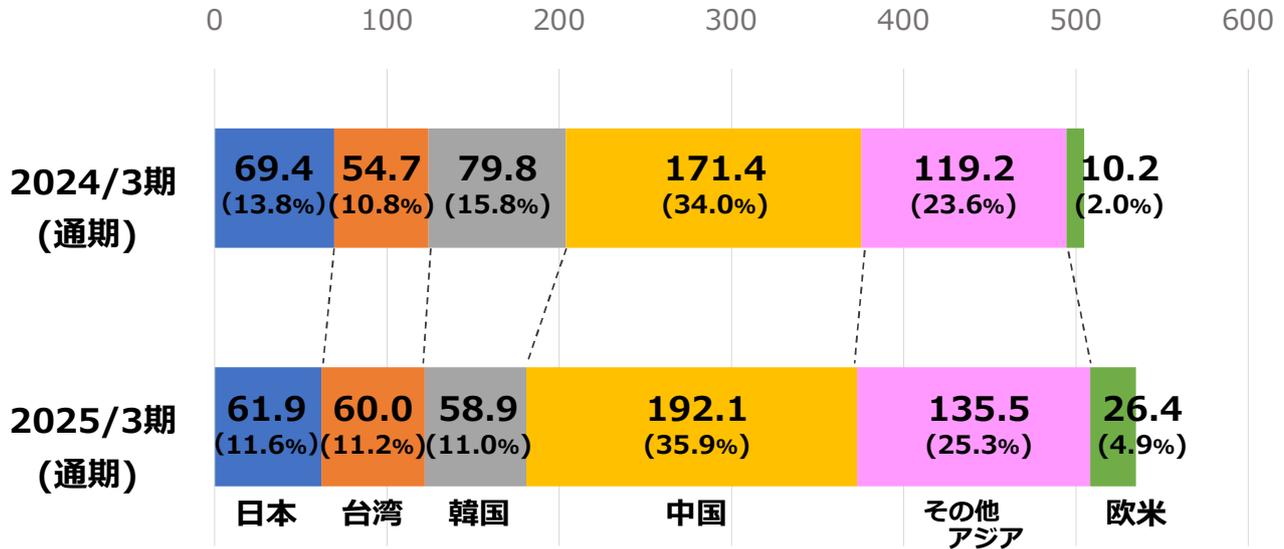


こちらは四半期ごとの受注高推移について地域ごとにまとめたものです。

参考としてご覧ください。

## 地域別売上構成比率（仕向地ベース）

（単位：億円）



こちらは地域別の売上高です。受注と同様に金額は仕向地ベースとなっております。

台湾は、新たな設備投資はまだ低調ではあるものの、金型売上やTSS（トータル・ソリューション・サービス）売上が増加しました。

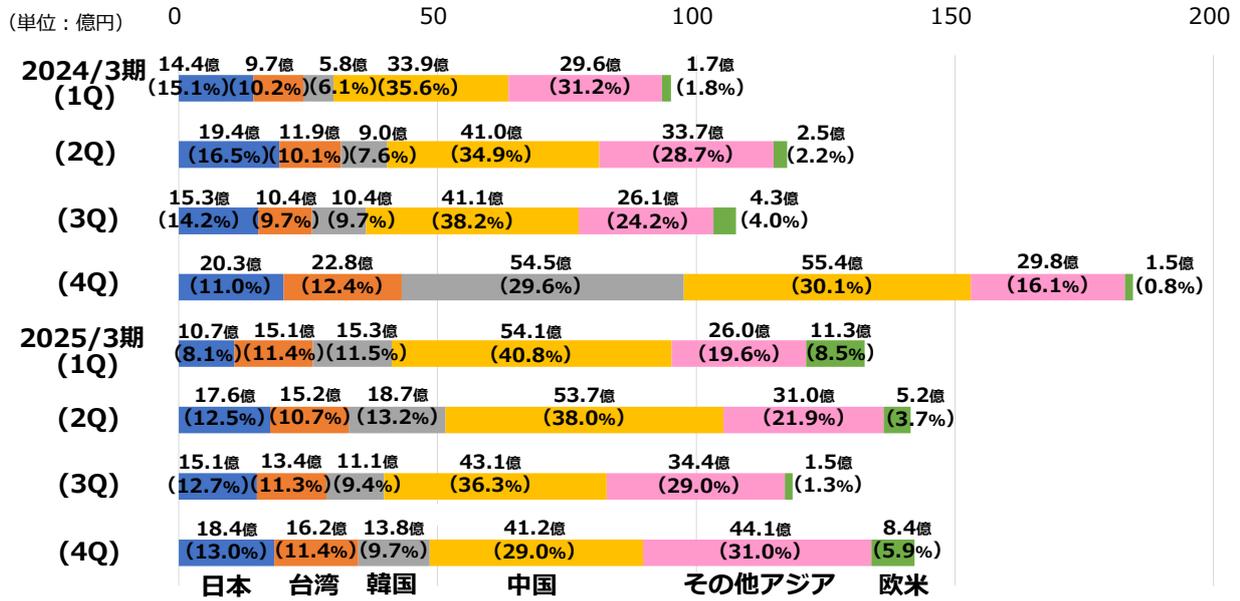
韓国は、受注同様、生成AI関連向けで前期に多くの売上が集中した反動により減少いたしました。

中国は、半導体内製化に向けた需要により、売上高が前期比で増加いたしました。

その他アジアは、地政学的リスクから活発な投資が継続し、売上高が前期比で増加いたしました。

なお、こちらも受注同様に、詳細なデータを決算補足資料として当社Webサイトに掲載しておりますので、あわせてご参照ください。

## 地域別売上構成比率推移（仕向地ベース）

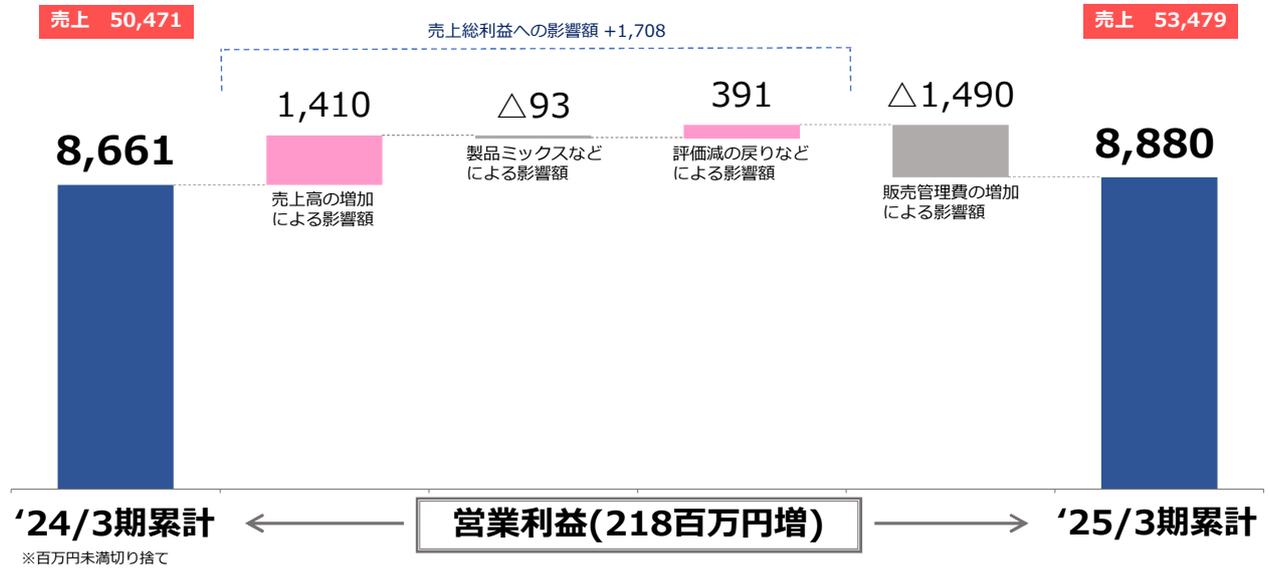


こちらは四半期ごとの売上高推移について地域ごとにまとめたものです。

参考としてご覧ください。

## 2025年3月期累計 連結営業利益 増減要因分析（対前年同期比）

（単位：百万円）



こちらは、2024年3月期通期と2025年3月期通期の営業利益増減要因分析です。

参考としてご覧ください。

## 主な説明内容

---

1. 2025年3月期 実績
2. **第二次中期経営計画**
3. 2026年3月期 予想
4. TOPICS

## 第二次中期経営計画テーマ（3カ年）

### TOWAイズムで次世代をリードする人財を創出

TOWAは10年先、20年先、30年先も業界トップであり続けるため、これまで以上に積極的に人財投資を行います。

#### TOWA人財戦略



第二次中期経営計画のテーマは「TOWAイズムで次世代をリードする人財を創出」です。

当社の競争力の源泉は人財であり、今後10年、20年、さらにその先も業界トップであり続けるためには、人財への投資をより積極的に行う必要があります。

なお、第二次中期経営計画の詳細につきましては、2025年3月28日に説明会を開催いたしました。当社ウェブサイト上に資料と説明会の動画を掲載しておりますので、ぜひご覧ください。

## 第二次中期経営計画 数値目標

(単位：億円)

	2025/3期 実績	→	2028/3期	2032/3期
売上高	534.7	+32.8%	710	1,000
営業利益	88.8	+75.7%	156	250
営業利益率	16.6%	+5.4pt	22.0%	25.0%
経常利益	94.0	+66.0%	156	250
当期純利益	81.2	+34.2%	109	175

※ 当期純利益 = 親会社株主に帰属する当期純利益

こちらは第二次中期経営計画の数値目標です。

3年後には売上高710億円、営業利益156億円、営業利益率22%を目指します。

## 第二次中期経営計画 数値目標

(単位：億円)

	2025/3期 実績	→	2028/3期
売上高	534.7	+32.8%	710
半導体事業	395.3	+31.8%	521
医療デバイス事業	22.6	+23.7%	28
新事業	94.2	+41.1%	133
レーザー事業	22.6	+24.1%	28

こちらは事業別の売上目標となります。

半導体事業は31.8%増、医療デバイス事業は23.7%増、新事業は41.1%増、レーザー事業は24.1%増を計画しております。

## 主な説明内容

---

1. 2025年3月期 実績
2. 第二次中期経営計画
3. 2026年3月期 予想
4. TOPICS

## 2026年3月期 通期 連結業績予想

(単位：億円)

	2025/3期 実績	2026/3期 予想	増減額	前期比
売上高	534.7	560.0	+ 25.2	+ 4.7%
営業利益	88.8	98.0	+ 9.1	+ 10.4%
営業利益率	16.6%	17.5%	+ 0.9pt	-
経常利益	94.0	98.0	+ 3.9	+ 4.3%
当期純利益	81.2	68.6	▲ 12.6	▲ 15.5%

※当期純利益＝親会社株主に帰属する当期純利益

こちらは2026年3月期の通期業績予想についてです。

通期の売上高は560億円、営業利益98億円、経常利益98億円、当期純利益68.6億円を予想しており、売上高は過去最高を見込んでおります。

前提となる市場環境などの詳細については、今期の市場見通しでご説明いたします。

なお、当期純利益が減益予想となっている理由は、前期の当期純利益には、一部の投資有価証券の売却による売却益が含まれていたためです。それらを除いた場合と比較すると、今期は増益を予想しております。

想定為替レートは1ドル＝148円ですが、取引の大部分は円建てで行われており、為替変動による影響は軽微となります。

## 2026年3月期 セグメント別売上予想

(単位：億円)

	2025/3期 実績	2026/3期 予想	増減額	前期比
<b>売 上 高</b>	<b>534.7</b>	<b>560.0</b>	<b>+ 25.2</b>	<b>+ 4.7%</b>
<b>半 導 体 事 業</b>	<b>395.3</b>	<b>411.5</b>	<b>+ 16.1</b>	<b>+ 4.1%</b>
<b>メ デ ィ カ ル デ バ イ ス 事 業</b>	<b>22.6</b>	<b>24.0</b>	<b>+ 1.3</b>	<b>+ 6.0%</b>
<b>新 事 業</b>	<b>94.2</b>	<b>101.5</b>	<b>+ 7.2</b>	<b>+ 7.7%</b>
<b>レ ー ザ 事 業</b>	<b>22.6</b>	<b>23.0</b>	<b>+ 0.4</b>	<b>+ 1.9%</b>

こちらはセグメント別の売上予想です。

半導体事業については、前年比4.1%増、医療デバイス事業は6.0%増、新事業は7.7%増、レーザー事業は1.9%増を見込んでおります。

## 設備投資・配当予想

	2025/3期 実績	2026/3期 予想
設備投資	53.9億円	52.0億円
配当	20.0円	20.0円

### ▶ 主な設備投資予定

- ・スマートファクトリー関連
  - ・各工場における新規生産設備導入や更新による生産能力UP
  - ・DX投資
  - ・メディカルデバイス事業、工具事業拡大に向けた投資
- ◆ その他M&A等は積極的に実施

※配当方針「安定・継続配当」に基づき、20.0円を計画しています。

こちらは設備投資と配当予想です。

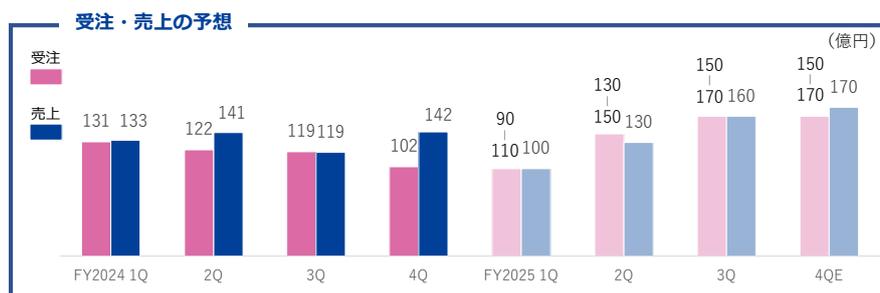
2025年3月期の設備投資は、韓国での新工場取得や金型工場のスマートファクトリー化、各生産工場での生産体制強化に向けた設備投資などが中心でした。2026年3月期につきましては、引き続き金型工場のスマートファクトリー化に向けた投資、各生産工場での生産体制強化に向けた設備投資など52億円を見込んでいます。

2026年3月期の配当につきましては、安定配当の施策を基に、2025年3月期と同額の20.0円を予定しています。

## 市場見通し

### 今期の市場見通し

- 生成AI市場は拡大基調が続き、関連設備投資は継続。
- 今期の前半は米国の通商政策が不透明なため投資様子見。
- 全体的な市場の回復は現時点では今期の後半を予想。



### 受注高予想

1Q	2Q
90-110億円	130-150億円
3Q	4Q
150-170億円	150-170億円

### 損益予想

売上高	560.0億円
営業利益	98.0億円
経常利益	98.0億円
当期利益	68.6億円

こちらは、今期の業績予想の前提となる市場見通しについてです。

生成AI関連市場については拡大基調を維持しており、関連設備投資も継続する見込みです。

一方、半導体市場全体に関しましては、米国の通商政策の先行きが不透明であるため、今期の前半は投資の様子見が続くと予想されます。

全体的な市場の回復は現時点では今期の後半を予想して、当社の業績につきましても後半にかけて徐々に回復を予想しております。

## 主な説明内容

---

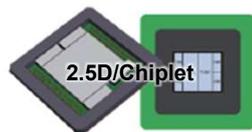
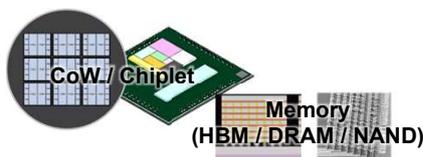
1. 2025年3月期 実績
2. 第二次中期経営計画
3. 2026年3月期 予想
4. TOPICS

## 戦略製品について

各ターゲット製品に対し、TOWAはそれぞれに最適な装置をラインナップ。  
パッケージ形状・用途に応じた設備選定を可能にしています。

モールドイングシステム  
シンギュレーションシステム

### - Target Product -



### - System Line-up -

#### CPM Series



#### YPM1250-EPQ



#### LSG1040



**TOWA** This material is the property of TOWA CORPORATION

23

こちらはTOWAの戦略製品についてです。

AIの拡大にともない、Chip on Wafer (CoW)、Chiplet、HBMなど、半導体パッケージが多様化しています。

TOWAはこれらに欠かせない技術を保有しており、それぞれに最適な製品をラインナップしています。

まず、CoWやHBMを含むメモリーに対応する製品として、CPMシリーズを提供しています。

独自のコンプレッション技術で、高い品質と生産性を実現しており、先端パッケージの生産に広く活用されています。

次に、2.5DやChipletに対応した製品として、YPM1250-EPQを提供しています。生成AIのように複雑な処理を高速に行うためには、半導体チップの性能を向上させる必要がありますが、同時に熱の発生によるパッケージの反りなどの課題も生じます。TOWAはこれらの課題を解決する技術を保有しており、AIに関連した複数のお客様から引き合いを頂いています。

次に、高速かつ、様々な形状のパッケージを切断可能なLSG1040（レーザシンギュレーション装置）を提供しています。

レーザシンギュレーションにつきましては、次ページにて詳細をご説明いたします。

## シングュレーション装置

### レーザシングュレーションプロセス開発

従来の半導体は□（四角）が主流。  
ウェアラブル製品では身に着けるとい  
目的から形状の自由度が求められる。

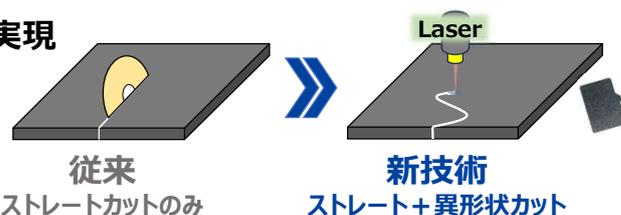


✓ 従来を超える**高速・非接触加工**で**高生産性の実現**

✓ **複雑・曲線的な形状**にも対応可能



LSG1040



従来  
ストレートカットのみ

新技術  
ストレート+異形状カット

高速かつ形状自由度を実現する  
TOWAの革新的ダイシングソリューション

こちらはシングュレーション装置についてです。

半導体の用途拡大や生産効率拡大のために活用が期待できる新たなレーザシングュレーションプロセスを開発いたしました。

新たなレーザシングュレーションプロセスでは従来を超える高速・非接触加工で高生産性の実現することができ、複雑・曲線的な形状のダイシングにも対応可能となっています。

ウェアラブル製品では身に着けるとい目的から半導体形状の自由度が求められており、新たなレーザシングュレーションプロセスの活用が期待できます。

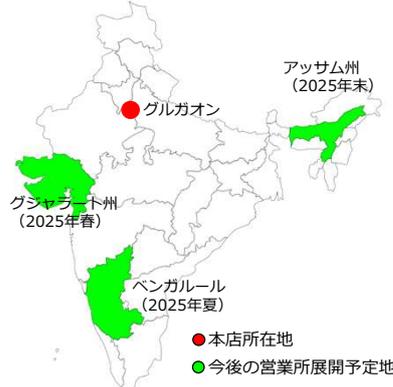
## インドでのビジネス強化

### インドにおける事業強化のため、販売子会社を設立

- ▶ インドでは政府支援のもと半導体産業育成に注力しており、すでに地場の大手財閥や世界の大手半導体メーカーによる投資が開始  
⇒ 現地で密着した営業およびサービス活動を展開し、立上げ期よりお客様の不安を取り除き、より強固な関係を築ける体制を構築

#### 会社概要

社名	TOWA Semiconductor India Pvt Ltd.
所在地	インド共和国 ハリヤナ州 グルガオン
事業内容	半導体製造装置・金型の販売およびアフターサービス



インド市場におけるビジネス強化についてです。

これまでシンガポールの販売子会社がインド地域を担当しておりましたが、よりビジネスチャンスの獲得および事業強化のため、現地グルガオンに販売子会社を設立いたしました。

インド国内は非常に広大な土地ですので、今後も顧客の動向に合わせて、より近い地域（グジャラート州、ベンガルールおよびアッサム州）において営業・サービス活動を行えるよう、拠点の増設を予定しております。

お客様に直接対面し、急激に立ち上がるインドの成長スピードに遅れることなく、ニーズを補足する体制を構築していきます。

T O W A ビ ジ ョ ン 2 0 3 2

# 「変革で世界の頂へ」



《本資料に関するお問合せ》TOWA株式会社 企画部

〒601-8105 京都市南区上鳥羽上調子町5番地 Tel : 075-692-0251

本資料には当社グループの計画や方針、財務、技術、製品、サービス、業績等に係る将来予想に関する記述が含まれております。将来予想に関する記述は、あくまで当社グループが現時点において入手可能なデータや仮定、方法等に基づき、当社グループが判断したものであり、様々なリスクや不確定な要因を含んでおります。また、新たなリスクや不確定要因は随時生じるものであり、その発生や影響を予測することは不可能であります。したがって、本資料に含まれる将来に関する記述は、実際の結果とは大きく異なる可能性があることをあらかじめご了承願います。